



2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2025年2月4日

上場会社名 株式会社東京精密 上場取引所 東
 コード番号 7729 URL <https://www.accrettech.com>
 代表者(役職名) 代表取締役社長COO (氏名) 木村 龍一
 問合せ先責任者(役職名) 代表取締役副社長CFO (氏名) 川村 浩一 TEL 042-642-1701
 配当支払開始予定日 —
 決算補足説明資料作成の有無 : 有
 決算説明会開催の有無 : 有 (証券アナリスト・機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

1. 2025年3月期第3四半期の連結業績(2024年4月1日~2024年12月31日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2025年3月期第3四半期	103,137	16.0	19,075	32.6	19,791	31.4	18,125	70.7
2024年3月期第3四半期	88,895	△13.8	14,386	△37.8	15,058	△36.4	10,615	△30.4

(注) 包括利益 2025年3月期第3四半期 18,361百万円(53.6%) 2024年3月期第3四半期 11,958百万円(△28.2%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2025年3月期第3四半期	448.08	444.19
2024年3月期第3四半期	263.33	260.54

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2025年3月期第3四半期	230,292	168,083	72.2
2024年3月期	225,524	158,427	69.4

(参考) 自己資本 2025年3月期第3四半期 166,242百万円 2024年3月期 156,560百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2024年3月期	—	89.00	—	103.00	192.00
2025年3月期	—	114.00	—	—	—
2025年3月期(予想)	—	—	—	114.00	228.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 2025年3月期の連結業績予想(2024年4月1日~2025年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	146,000	8.4	28,500	12.6	28,500	7.7	23,300	20.2	575.95

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更 : 無
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有
 - ② ①以外の会計方針の変更 : 無
 - ③ 会計上の見積りの変更 : 無
 - ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	2025年3月期3Q	42,164,081株	2024年3月期	42,104,381株
② 期末自己株式数	2025年3月期3Q	1,705,241株	2024年3月期	1,705,058株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2025年3月期3Q	40,451,168株	2024年3月期3Q	40,313,793株

(注) 当社は、中間連結会計期間より株式給付信託（BBT）を導入しており、期末自己株式数及び期中平均株式数の算定上控除する自己株式数には株式給付信託（BBT）に係る信託財産として、株式会社日本カストディ銀行（信託E口）が保有する当社株式（2025年3月期第3四半期 200,000株）が含まれています。

※ 添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー : 無

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的と判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は、様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想のご利用にあたっては、添付資料「1. 当四半期決算に関する定性的情報（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	6
四半期連結包括利益計算書	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(会計方針の変更)	8
(追加情報)	8
(セグメント情報等)	9
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)	9

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間における世界経済は、米国では個人消費の増加など内需を中心に経済は堅調に推移しましたが、不動産不況下にある中国では政府の支援政策があるものの依然として消費の低調が続き、欧州では景気停滞を踏まえ中央銀行が再度の利下げを実施しました。日本の景気も、円安等による物価上昇を受け緩やかな回復にとどまるなど、総じて不透明な状況が続きました。

このような状況下、当社を取り巻く環境は、半導体製造装置部門では、民生エレクトロニクス関連需要は回復が遅れている中、生成A I 関連需要や各種半導体デバイスの国産化を進める中国需要が底堅さを維持しました。計測機器部門では、新規投資の停滞が続く中、更新需要が下支えとなりました。

その結果、当第3四半期連結累計期間の連結業績は、受注高 1,103 億 69 百万円（前年同期比 23.1%増）、売上高 1,031 億 37 百万円（前年同期比 16.0%増）となり、利益面では、営業利益 190 億 75 百万円（前年同期比 32.6%増）、経常利益 197 億 91 百万円（前年同期比 31.4%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は 181 億 25 百万円（前年同期比 70.7%増）となりました。

当第3四半期連結累計期間のセグメント別概況は以下の通りです。

【半導体製造装置部門】

半導体製造装置部門では、生成A I 関連の半導体パッケージ向け加工装置、メモリ半導体向け検査装置需要のほか、各種半導体デバイスや電子部品の国産化を進める中国需要が、前期から引き続き底堅さを維持しました。民生エレクトロニクス製品、E V 向け半導体需要伸び悩みによるOSAT(後工程受託企業)向けやパワー半導体向け装置需要が軟調な中で、これらの需要が下支えとなり、受注高は前年同期比で増加しました。

売上面では、概ね顧客要求納期に沿った出荷を進めたことで、前年同期比で増加しました。

この結果、当四半期の当部門業績は、受注高 811 億 69 百万円（前年同期比 29.9%増）、売上高 773 億 62 百万円（前年同期比 19.9%増）、営業利益は 155 億 89 百万円（前年同期比 43.1%増）となりました。

【計測機器部門】

計測機器部門では、汎用・自動計測機器の対象市場となる自動車・機械部品などの業界における新規設備向けの投資が停滞しましたが、更新需要を幅広く獲得したことや二次電池用充放電試験装置事業において国内自動車メーカーより一定の受注を獲得したこと等により、受注高は前年同期比で増加しました。

売上面では、概ね計画通りの出荷となり、前年同期比で増加しました。

この結果、当四半期の当部門業績は、受注高 291 億 99 百万円（前年同期比 7.5%増）、売上高 257 億 74 百万円（前年同期比 5.9%増）、営業利益は 34 億 86 百万円（前年同期比 0.2%減）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

【資産、負債及び純資産の状況】

当第3四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ 47 億 67 百万円増加し、2,302 億 92 百万円となりました。その主な要因は、現金及び預金の増加 162 億 41 百万円、受取手形、売掛金及び契約資産、電子記録債権の減少 101 億 79 百万円、製品、原材料、仕掛品などの棚卸資産の増加 77 億 7 百万円、有形固定資産の減少 44 億 78 百万円等です。

当第3四半期末の負債は、前連結会計年度末に比べ 48 億 88 百万円減少し、622 億 8 百万円となりました。その主な要因は、長期借入金の減少 40 億円、支払手形及び買掛金、電子記録債務の増加 8 億 34 百万円、賞与引当金の増加 4 億 47 百万円等です。

当第3四半期末における純資産は、前連結会計年度末に比べ 96 億 56 百万円増加し、1,680 億 83 百万円となりました。自己資本比率は、72.2%となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

足許の状況を勘案し、2024年11月1日に発表した2025年3月期通期業績予想を以下の通り修正します。今回の修正では、主に半導体製造装置部門の業績予想を修正(上方修正)しております。

(2025年3月期通期)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益	1株あたり当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円
前回発表予想(A) (2024年11月1日発表)	145,000	28,000	28,000	23,000	568.57
今回修正予想(B)	146,000	28,500	28,500	23,300	575.95
増減額(B-A)	1,000	500	500	300	—
増減率	0.7%	1.8%	1.8%	1.3%	—
前年実績 (2024年3月期)	134,680	25,307	26,453	19,378	480.49

(注) 業績見通し等の将来に関する記述は、内外の経済状況、為替レートの変動、業績に影響を与えるその他の要因等現時点で入手可能な情報をもとに、当社グループが合理的であると判断した一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。これらは、市況、競争状況、新製品の導入及びその成否を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、実際の売上高及び利益は、記載されている予想数値とは大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	36,782	53,023
受取手形、売掛金及び契約資産	35,497	25,857
電子記録債権	7,303	6,763
商品及び製品	2,254	3,213
仕掛品	38,682	44,928
原材料及び貯蔵品	26,288	26,790
その他	7,056	4,125
貸倒引当金	△33	△35
流動資産合計	153,831	164,668
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	28,723	27,750
その他(純額)	27,273	23,769
有形固定資産合計	55,997	51,519
無形固定資産		
のれん	255	222
その他	3,814	3,518
無形固定資産合計	4,069	3,741
投資その他の資産		
その他	11,738	10,475
貸倒引当金	△112	△112
投資その他の資産合計	11,626	10,363
固定資産合計	71,693	65,624
資産合計	225,524	230,292

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	8,517	9,018
電子記録債務	9,328	9,661
短期借入金	1,300	1,300
1年内返済予定の長期借入金	5,000	5,000
未払法人税等	2,600	2,879
契約負債	9,981	9,660
賞与引当金	2,228	2,676
役員賞与引当金	15	13
その他	7,030	6,118
流動負債合計	46,002	46,328
固定負債		
長期借入金	18,000	14,000
役員退職慰労引当金	44	52
退職給付に係る負債	1,171	1,200
資産除去債務	103	104
訴訟損失引当金	960	—
その他	813	523
固定負債合計	21,094	15,880
負債合計	67,097	62,208
純資産の部		
株主資本		
資本金	11,450	11,560
資本剰余金	22,593	23,148
利益剰余金	124,705	134,034
自己株式	△7,983	△8,430
株主資本合計	150,765	160,312
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	989	1,020
為替換算調整勘定	3,674	3,909
退職給付に係る調整累計額	1,130	1,000
その他の包括利益累計額合計	5,794	5,930
新株予約権	1,082	955
非支配株主持分	784	885
純資産合計	158,427	168,083
負債純資産合計	225,524	230,292

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自2023年4月1日 至2023年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自2024年4月1日 至2024年12月31日)
売上高	88,895	103,137
売上原価	52,697	60,471
売上総利益	36,197	42,666
販売費及び一般管理費	21,811	23,590
営業利益	14,386	19,075
営業外収益		
受取利息	33	33
受取配当金	137	251
為替差益	308	131
投資事業組合運用益	134	66
受取補償金	16	108
その他	233	274
営業外収益合計	862	866
営業外費用		
支払利息	68	99
固定資産除売却損	64	1
輸送事故による損失	39	—
その他	19	48
営業外費用合計	191	150
経常利益	15,058	19,791
特別利益		
新株予約権戻入益	6	10
投資有価証券売却益	23	179
固定資産売却益	—	4,303
特別利益合計	29	4,493
特別損失		
関係会社清算損	—	40
割増退職金	14	117
特別損失合計	14	157
税金等調整前四半期純利益	15,073	24,127
法人税、住民税及び事業税	3,343	6,122
法人税等調整額	1,009	△187
法人税等合計	4,353	5,935
四半期純利益	10,719	18,192
非支配株主に帰属する四半期純利益	104	66
親会社株主に帰属する四半期純利益	10,615	18,125

四半期連結包括利益計算書
第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自2023年4月1日 至2023年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自2024年4月1日 至2024年12月31日)
四半期純利益	10,719	18,192
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	176	30
為替換算調整勘定	1,188	269
退職給付に係る調整額	△126	△129
その他の包括利益合計	1,238	169
四半期包括利益	11,958	18,361
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	11,826	18,260
非支配株主に係る四半期包括利益	131	101

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業的前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(会計方針の変更)

(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用)

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)、
「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 2022年10月28日)及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日)を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しています。これによる四半期連結財務諸表への影響はありません。

(追加情報)

(取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入)

当社は、2024年6月21日開催の第101期定時株主総会決議に基づき、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)及び執行役員並びに当社の指定する子会社及び関連会社の一部の取締役(社外取締役を除く)及び執行役員を対象に、取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」を導入しています。

(1)取引の概要

本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、対象役員に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」といいます。)が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度です。

なお、本制度においては、「第1給付」及び「第2給付」の2種類の給付を行うこととし、対象役員が当社株式等の給付を受ける時期は、第1給付については原則として対象役員の退任時となり、第2給付については原則として毎年一定の時期となります。

(2)信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、当該信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しています。当第3四半期連結会計期間末における当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、それぞれ1,381百万円、200,000株です。

(セグメント情報等)

前第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント		合計
	半導体製造装置	計測機器	
売上高			
外部顧客への売上高	64,549	24,345	88,895
セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	—
計	64,549	24,345	88,895
セグメント利益	10,894	3,492	14,386

(注) セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と一致しています。

当第3四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント		合計
	半導体製造装置	計測機器	
売上高			
外部顧客への売上高	77,362	25,774	103,137
セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	—
計	77,362	25,774	103,137
セグメント利益	15,589	3,486	19,075

(注) セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と一致しています。

(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりです。

	前第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)
減価償却費	3,359百万円	3,765百万円
のれんの償却額	34百万円	36百万円